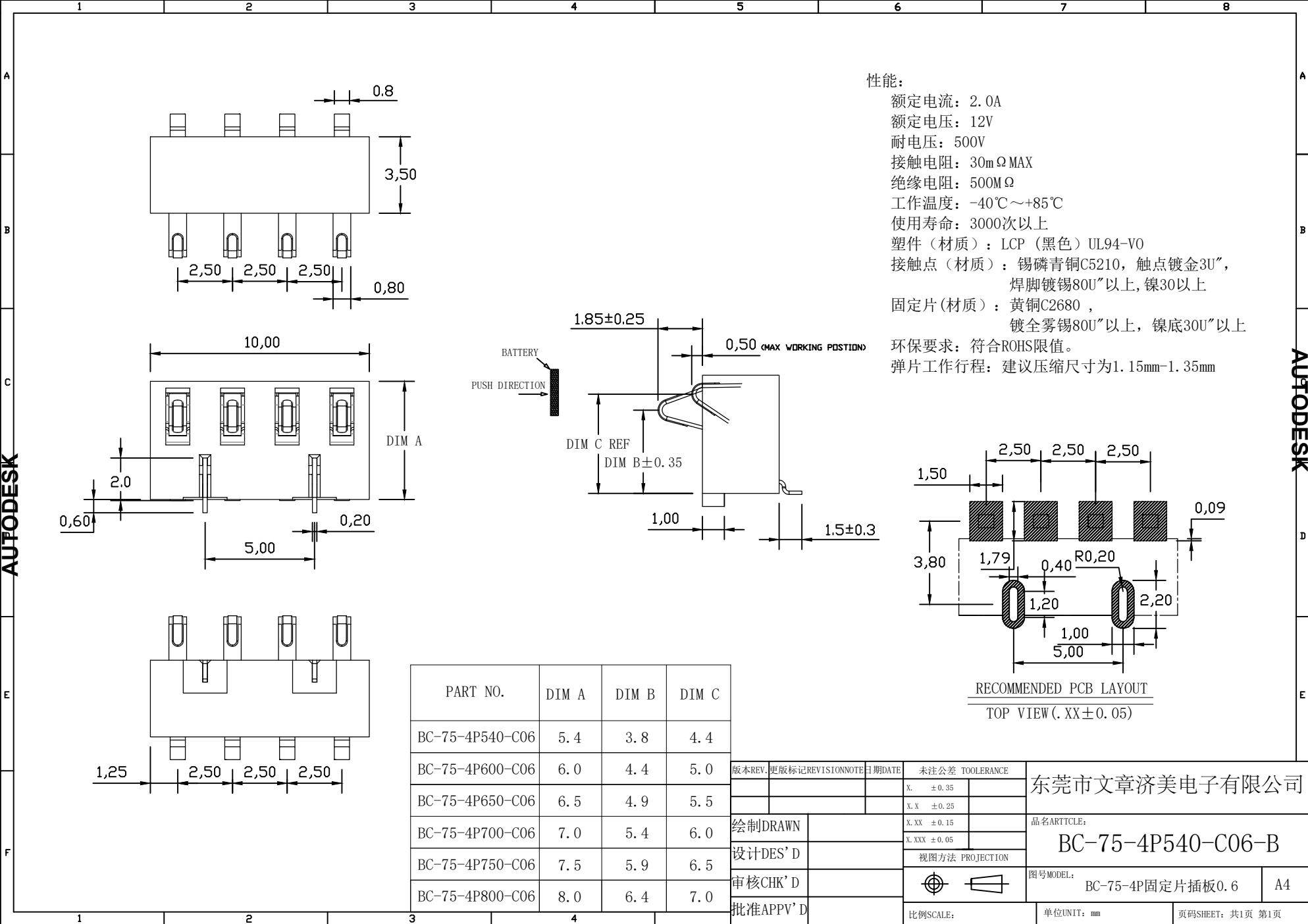




规格书

SERTES 系列： 电 池 连 接 器

1. RATING 额定值： 2.0A 12V

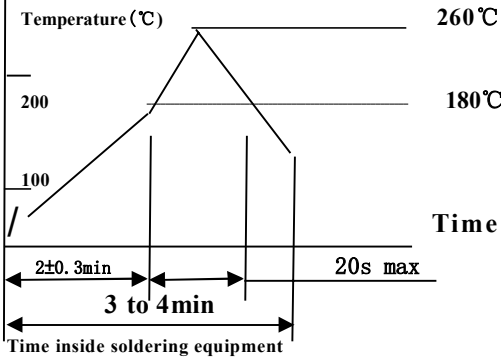
2 . OPERATING TEMPERATUER RANGE IS-55℃ TO 125℃ 。 IT IS USUALLY APPLIED TO ELECTRONIC AND ELECTRICAL APPLIANCE PRODUCTS。

温度 -55℃~125℃环境温度内使用。一般适用电子、电气方面产品使用

。 3 . STORAGE TEMPERATURE RANGE: -40℃~85℃ 。

保存温度 范围：-40℃~85℃。

ITEM 项目		TEST CONDITION 测试条件	PERFORMANCE 性能
4 . ELECTRICAL PERFORMANCE 电气性能			
4. 1	CONTACT RESISTANCE 接触电阻	Being tested at 1kHz small current and voltage (100mA , 20mV) by contact resistance meter. 在 1kHz 小电流 电压（100mA , 20mV）下测量 。	30m Ω max. 30 毫欧以下。
4. 2	INSULATION RESISTANCE 绝缘电阻	DC 500v shall be applied for test between terminals and between terminals and frame for one minute. 在端子之间和端子与壳之间加 DC500V 条件下，持续 1 分钟测量 。	500M Ω min. 500 兆欧以上。
4. 3	WITHSTAND VOLTAGE 耐电压	AC 500V and induction current 1mA shall be applied for test between terminals and between terminals and frame for one minute. 在端子之间和端子与壳之间加 AC500V（50Hz 或 60Hz）感应电流 1mA 条件下，持续 1 分钟测量 。	There shall be no breakdown. 无击穿现象出现。
5. MECHANICAL PERFORMANCE 机械性能			
5. 1	TERMINAL STRENGTH 端子强度	A static force of 300g being applied in one direction on the tip of the terminal for 1 mintue. 一个 300 克之静负荷施加于端子顶部的一个方向 持续 1 分钟。	There is no indication of Mechanical or electrical damage 无任何迹象显示机械及电器性能之损坏。

ITEM 项目	TEST CONDITION 测试条件	PERFORMANCE 性能
6. DURABILITY 耐久性		
6. 1	SOLDERING TEST 可焊性试验 The tip of the terminal shall be dipped 2mm in the solder bath within temperature of $230\pm 5^{\circ}\text{C}$ for 3s. 端子顶部被侵入锡池2mm深，温度 $230\pm 5^{\circ}\text{C}$ ，时间 3 秒。	Over 75% of the immersed surface was covered by tin . 侵入的部分 75%以上表面将被锡覆盖
6. 2	SOLDERING RESISTANT TEST 耐焊性试验 Soldering temperature $260\pm 5^{\circ}\text{C}$,soldering time $3\pm 0.5\text{s}$,immersion depth up to the surface of the board, thickness of PCB 1.6mm. 焊炉焊的温度 控制在 $260\pm 5^{\circ}\text{C}$ ，时间为 3 ± 0.5 秒，于（基板）厚度 1.6mm. Manual soldering temperature $260\pm 5^{\circ}\text{C}$, soldering time $3\pm 0.5\text{s}$,however excessive pressure shall not be applied to the terminal. 手焊接时温度控制在 $260\pm 5^{\circ}\text{C}$ ，时间为 3 ± 0.5 秒，但不能在端子上施加异常压力。	Without deformation of case or excessive looseness of electrical properties 本体无变形，能满足机械、电气性能。
6. 3	REFLOW SOLDERING HEAR TEST 回流焊接热试验  *Temperature means the temperature of the PC board surface *温度 指PC板表面温度。	Without deformation of case or excessive looseness of electrical properties 本体无变形，能满足机械、电器性能。

ITEM 项目		TEST CONDITION 测试条件	PERFORMANCE 性能
6. 4	LIFE TEST 寿命测试	3000cycles of operation at a rate of 15-20 cycles per minute with unloading 无负载条件，每分钟15-20次的速度 操作3000次。	(1) Contact resistance 50mΩ 接触电阻 50毫欧以下。 (2) Operating force 30% initial value. 动作力变化范围初始值 30%。
6. 5	HEAT RESISTANT TEST 耐热试验	85 ± 2 °C for 96H, test after keeping in normal condition for 30min. 在 85±2℃环境中放 96 小时，再置于正常环境中，30 分钟后进行测试。	(1) Contact resistance 50mΩ. 接触电阻 50毫欧以下。 (2) insulation resistance 500M Ω min. 绝缘电阻 500 兆欧以上。 (3) there shall be no sign of mechanical and electrical damage. 无任何迹象显示机械及电器性能之损坏。
6. 6	MOISTURE RESISTANT TEST 耐湿试验	40±2°C 90% ~ 95% RH for 96H, test after keeping in normal condition for 30min. 在 40±2°C 90%~95%环境中放 96 小时，再置于正常环境中，30 分钟后进行测试。	
6. 7	COLD RESISTANT TEST 耐冷试验	At -40±3°C for 96H, test after keeping in normal condition for 30min. 在-40±3℃环境中放 96 小时，再置于正常环境中，30 分钟后进行测试。	
6. 8	TEMPERATURE CYCLING TEST 温度交变试验	According to following figure, after 5cycles, test after keeping in normal condition for 30min. 如图示之环境中，循环 5 次后，再置于正常环境中，30 分钟后进行测试。 